



・特徴

長尺の帯状、紐状基材に成膜するための装置です。基材の巻出し室(ロード室)の後及び巻取り室(アンロード室)の前に、各々バッファ室が設けられ、バッファ室の間にエッチング室、冷却室、スパッタリング室が配置されています。有機基材への成膜も出来ます。

・仕様

到達圧力	$\times 10^{-4}$ Pa 台※常温・無負荷・脱ガス時
排気速度	$\times 10^{-4}$ Pa 台迄 45 分以内※常温・無負荷・脱ガス時
成膜室径	650mmW×350mmD×370mmH
ロード室径	900mmW×500mmD×350mmH
アンロード室径	900mmW×500mmD×350mmH
スパッタ用電源	RF 電源 13.56MHz 500W 自動マッチング 1 台 逆スパッタ用 RF 電源 13.56MHz 300W 自動マッチング 1 台
基板形状	帯状 60mm 巾×15000mmL
膜厚分布	±5%以内
ターゲット寸法	3 インチ(金属・絶縁物)
ターゲット個数	2
基板回転	ローラ
基板加熱	無し
真空排気系(成膜室)	油回転ポンプ : 1300L/min 2 台 900L/min 1 台 クライオポンプ : 1000L/sec 2 台 500L/sec 1 台
真空排気系(L, UL 室)	油回転ポンプ : 1300L/min ターボ分子ポンプ : 1000L/sec
操作方法	自動
ガス系統	マスフローコントローラ 3 系統
ユーティリティ	電気 : AC200V 三相 32KVA 冷却水 : 20L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25°C 以下循環 計装エア : 0.5MPa 以上 設置寸法 : 5000mmW×1500mmD×1800mmH